

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成24年12月20日(2012.12.20)

【公開番号】特開2011-100916(P2011-100916A)

【公開日】平成23年5月19日(2011.5.19)

【年通号数】公開・登録公報2011-020

【出願番号】特願2009-255946(P2009-255946)

【国際特許分類】

H 05 K 7/20 (2006.01)

【F I】

H 05 K 7/20 B

【手続補正書】

【提出日】平成24年11月6日(2012.11.6)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0010

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0010】

上記目的を達成するために、請求項1記載の電子部品の放熱用実装構造は、第1の電子部品と、第2の電子部品とを備えた電子部品の放熱用実装構造において、前記第1の電子部品から前記第2の電子部品に熱伝導するように前記第1の電子部品と前記第2の電子部品との間に架設される受動部品を有することを特徴とする。

【手続補正2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

第1の電子部品と、第2の電子部品とを備えた電子部品の放熱用実装構造において、前記第1の電子部品から前記第2の電子部品に熱伝導するように前記第1の電子部品と前記第2の電子部品との間に架設される受動部品を有することを特徴とする電子部品の放熱用実装構造。

【請求項2】

前記受動部品は、前記第1の電子部品が備える電源供給端子と前記第2の電子部品が備える電源供給端子との間に架設されることを特徴とする請求項1に記載された電子部品の放熱用実装構造。

【請求項3】

前記受動部品は、抵抗器であることを特徴とする請求項2に記載された電子部品の放熱用実装構造。

【請求項4】

前記受動部品の消費電力は、前記第1の部品の消費電力よりも少ないことを特徴とする
請求項1乃至3いずれか1項に記載の電子部品の放熱用実装構造。

【請求項5】

前記受動部品の消費電力は、前記第2の部品の消費電力よりも少ないことを特徴とする
請求項4に記載の電子部品の放熱用実装構造。

【請求項6】

前記受動部品は、セラミック材を含むことを特徴とする請求項 1 乃至 5 いずれか 1 項に記載の電子部品の放熱用実装構造。

【請求項 7】

前記第 1 の電子部品は第 1 の I C チップであり、前記第 2 の電子部品は第 2 の I C チップであることを特徴とする請求項 1 乃至 6 いずれか 1 項に記載の電子部品の放熱用実装構造。

【請求項 8】

前記受動部品は、前記第 1 の I C チップの不使用端子と前記第 2 の I C チップの不使用端子とに接続されていることを特徴とする請求項 7 に記載の電子部品の放熱用実装構造。